

Call for Papers

31. FED-Konferenz

20. und 21. September 2023
Kongress am Park Augsburg



Mission Future – Aufgaben und Chancen für den Elektronikstandort Europa

Die Schwerpunkte 2023. Reichen Sie Ihren Vortrag ein!

Leiterplatten- und Baugruppendesign

- Robuste, zuverlässige Hardware designen
- Leiterplattentechnologien und Basismaterial
- Fertigungsgerechtes Design
- Signal-/Power-Integrität, Wärmemanagement
- Praxistipps für EDA- und Simulations-Tools
- Datenerstellung und -austausch

Aufbau- und Verbindungstechnik

- Embedding und Systemintegration
- Dreidimensionale Schaltungsträger
- Chancen additiver Fertigungsprozesse
- Miniaturisierung und Packaging

Baugruppenfertigung und EMS

- Lötprozesse und Teststrategien
- Automatisierung von Prozessen durch KI
- Virtuelle Fertigung und digitaler Zwilling
- Digitale Konnektivität
- Produktivität und Qualität verbessern
- Energie- und Materialverbrauch senken

Best Practice-Lösungen für KMU

- Beschaffungs- und Lieferkettenmanagement
- Digitalisierung von Geschäftsprozessen
- Cybersicherheit
- Mitarbeiter und Nachwuchs gewinnen
- Arbeitsorganisation und Mitarbeiterführung
- Unternehmensnachfolge

Strategien für den Standort Europa

- Digitale Transformation und Geschäftsmodelle
- Nachhaltig entwickeln und fertigen
- Resilienz steigern
- Kunden gewinnen und Mehrwert bieten
- Märkte erschließen und Nischen besetzen

Gesetzliche Regulierung

- Zulassung und Freigabe von Produkten
- Compliance
- Life Cycle Management
- CO2-Bilanzierung/ -fußabdruck
- Zertifizierungen, Gesetze, Richtlinien

Als Richtwert für die Redezeit empfehlen wir 35 Minuten. Auch Vorschläge für weitere Fachthemen sind willkommen. Die Programmkommission entscheidet, welche der fristgerecht eingesendeten Vorschläge für die 31. FED-Konferenz geeignet sind.

Die FED-Konferenz: Die Plattform der Elektronikindustrie

Die Krisen der vergangenen Jahre haben auch die Elektronikindustrie, die starke Abhängigkeit von China und Asien schmerzhaft spüren lassen. Der lokale Service und die deutlich geringeren Risiken einer Produktion in Europa sind gefragter denn je; die Lösungskompetenz, Verbindlichkeit und Flexibilität der hiesigen Lieferanten geschätzt. Zugleich stehen die Unternehmen vor vielen neuen Herausforderungen, die sie meistern müssen.

Jedes Jahr im September bringt die Konferenz des FED, Fachverband Elektronikdesign und -fertigung e.V., Praktiker, Entscheider und angewandte Forschung zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zusammen. Die zweitägige Konferenz mit begleitender Ausstellung und 350 Teilnehmern ist eine beliebte Plattform, um praxiserprobte Methoden und Herangehensweisen für die Entwicklung und Fertigung von Elektronik-Hardware zu diskutieren und sich über Prozesse, Lösungen und Trends zu informieren.

Das Markenzeichen der FED-Konferenz: Hier fließen Technologien, Prozesse und Best Practices für die Entwicklung und Fertigung von Leiterplatten und elektronischen Baugruppen zusammen. Die Veranstaltung richtet sich an Leiterplatten- und Baugruppendesigner, Fertigungsspezialisten, Prozess- und Qualitätsverantwortliche sowie Entscheider aus Management, Einkauf und Vertrieb.

Die FED-Konferenz im Überblick

- Thema: alle Technologien und Prozesse für die Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen und Systemen
- Teilnehmer: Leiterplatten- und Baugruppendesigner, Fertigungsspezialisten, Projektleiter, Einkäufer und Entscheider
- Fachvorträge und Expertenrunden in vier parallelen Slots
- mitreißende Keynotes
- Rahmenprogramm zum Netzwerken
- begleitende Fachausstellung

Der Nutzen für Sie als Redner

- Sie präsentieren Ihr Wissen vor Fachpublikum (ca. 350 Teilnehmer)
- Sie sind am Tag Ihres Vortrages und am Festabend am 20. September unser Gast (exklusiv Hotel)
- Sie erreichen Ihre Zielgruppe und pflegen wertvolle Geschäftskontakte
- Das Konferenzmarketing verschafft Ihnen hohe Aufmerksamkeit für Ihr Thema in den Print- und Online-Medien und Reputation in den sozialen Netzwerken

Einsendeschluss für Abstracts: 24. März 2023

Bitte reichen Sie einen Vortragsabstract bis zum 24. März 2023 über unser Online-Formular ein:

www.fed-konferenz.de/cfp

Ihr Ansprechpartner



**Fachverband Elektronikdesign
und -fertigung e.V.**

Thomas Bujotzek

Referent Technik und Elektronik

Tel: +49 30 340 6030 55

E-Mail: t.bujotzek@fed.de

FED

— Wir verbinden

www.fed-konferenz.de